

開示の要約

研磨方法および研磨装置

- 5 ウェハなどの基板の研磨中にエラーが起きた場合には、その基板の膜厚を測定する工程を実行する研磨方法および研磨装置が開示される。研磨方法は、複数の基板を研磨し、研磨された複数の基板のうち予め指定された少なくとも1枚の基板の膜厚を測定し、複数の基板のうちのいずれか1つの基板を研磨しているときに研磨エラーが起きたときは、その基板の膜厚を測定する工程を含む。

10

図 5